

证券代码: 688693

证券简称: 锆威特

公告编号: 2026-030

苏州锆威特半导体股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要风险提示:

苏州锆威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日披露了《苏州锆威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金方式向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等 26 名交易对方购买其合计持有的晶艺半导体有限公司 100% 股份，并募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法规，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2026年3月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于<苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。

2026年5月8日，公司披露了《苏州锴威特半导体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-025）。

截至本公告披露日，公司及相关各方中介机构正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。待审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布的公告为准。

公司于2026年3月28日披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年5月29日